

電気・電子・情報系企画Ⅰ 講演

『プリント配線板の現状と課題』

【講演概要】

設計からプリント配線板実装までの工程に関する変遷と課題を整理し、今後求められる技術とは何かを述べていく。

手設計から CAD へ、図面保管がフィルムからデータ保管へ、印刷から写真法へ、金型から NC 加工へ、ロジンフラックスから OSP へ、手挿入から自動挿入へ、手はんだ付けから自動はんだ付けへ、基板修理から基板交換へと変化しているが、これらの変化がこれからの自然環境を考慮した製品化実現とは必ずしも合致していないのではないかと懸念されている。

電機業界が置かれた環境は従来のものであり、これを継続するだけでは解決できない。

このため、改めて顧客の目線から商品化を行う必要があり、商品化＝低価格化でなく、性能と価格面を顧慮した地域毎の商品化が求められている。

【日 時】

平成 24 年 9 月 21 日（金） 9：00～10：30

【場 所】

神奈川県立産業技術短期大学校 会場（1402 教室）

【講師プロフィール】

（株）カヤバオフィス 代表取締役

元ソニー（株）実装技術部

テクニカルサポートセンター推進本部 課長

生産技術部にて回路設計（回路図、実装設計、製造技術）に従事

プリント配線板技能検定 特級技能士取得

JPCA（日本電子回路工業会）めっき部会等専門委員歴任

同協会 発行「ぷりんとはんじゅくⅤ」新入社員のための実装入門」著書

「ぷりんとはんじゅくⅥ」実装入門 2」著書

榎場正男 先生